



NEWS RELEASE

2013年11月19日
東ソー株式会社

【トーソー・SMD】 450mm用スパッタリングターゲット製造設備を新設

東ソーグループのトーソー・SMDはこの度、半導体市場における次世代のウエハーサイズである450mm用スパッタリングターゲットの製造設備新設を決定しました。

東ソーの高機能材料事業で取り扱うスパッタリングターゲットは、半導体・フラットパネルディスプレイ・太陽電池などのエレクトロニクス分野における薄膜形成材料として使用されており、今後もさらなる需要の拡大が見込まれています。

半導体製造時に使用されるウエハーサイズは、現在主流となっている300mmから、2017～2018年には、生産性に優れた次世代サイズの450mmに移行することが見込まれています。

当社は本計画の実施により、旺盛な需要の拡大に対応するとともに、高機能材料事業のさらなる収益力強化を図っていきます。

記

1. 本計画内容

- | | |
|----------|--------------------------|
| (1) 立地 | トーソー・SMD（米国オハイオ州）工場敷地内 |
| (2) 対象設備 | 450mm用スパッタリングターゲット製造設備一式 |
| (3) 着工 | 2013年10月 |
| (4) 完工予定 | 2014年12月 |

2. トーソー・SMD 会社概要

- | | |
|----------|-------------|
| (1) 設立 | 1988年6月 |
| (2) 本社 | 米国オハイオ州 |
| (3) 出資比率 | 東ソー100%間接出資 |

以上